证券代码：300689　　证券简称：澄天伟业　　编号：2026-009

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研　□ 分析师会议 □ 媒体采访　□ 业绩说明会 □ 新闻发布会　□ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 2026 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 11 月 26 日 (周四) 下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开
上市公司接待人员姓名	1、独立董事 兰才明 2、独立董事 韩燕 3、董事会秘书、财务负责人 蒋伟红 4、证券事务代表 陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	**投资者提出的问题及公司回复情况** 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： **Q1、贵司液冷业务尚处于小批量交付及产能爬坡阶段，未来在由液冷零部件向系统级解决方案延伸时，是否考虑与具备成熟液冷系统集成技术及客户认证基础的企业开展深度产业协同。** 答：尊敬的投资者您好！公司液冷业务当前正处于小批量交付及产能爬坡期，现阶段优先保障核心零部件的量产稳定性与品质迭代。公司具备零部件层面的客户认证与批量交付基础，拥有从机加工、焊接、组装到清洗检测的全流程生产能力，可面向终端客户提供系统级液冷方案。液冷系统方案的落地涉及集成设计、多环节客户认证、现场实施等多重壁垒，公司认可产业分工协同的价值，在向系统级解决方案延伸的过程中，对与具备成熟系统集成能力和客户认证基础的企业开展合作持开放态度，多方优势互补可加快方案验证与市场落地。公司将持续积累系统层面技术能

	力，结合订单与客户需求动态推进。若后续达成重要合作，将依规履行信息披露义务。感谢您的关注！ **Q2、您好，贵公司液冷业务的竞争格局和自身定位如何？在台系主导、认证周期长的格局下，公司液冷业务的护城河在哪里？** 答：尊敬的投资者您好！当前液冷行业参与者持续增加，相关产品通常需要经过较长时间的客户验证和工艺爬坡，对钎焊密封性、流道一致性、生产洁净度及批次测试稳定性等方面要求较高。公司已取得核心客户供应商代码并实现小批量出货，完成初期产线建设，具备承接批量订单的生产条件和交付能力。公司竞争力在于（1）在高导热金属材料、蚀刻、电镀、钎焊等工艺方面拥有深厚积累和独到技术；（2）作为早期就进入该供应链体系的核心供应商，与客户共同经历了多代产品的迭代，双方在技术理解、工艺储备与迭代节奏上保持同步，合作关系和行业积累难以在短期内被复制。（3）具备从机加工、焊接、组装到清洗检测的全流程生产能力，在保证产品一致性和可靠性方面建立了较高的壁垒，可面向终端客户提供整套系统级解决方案。感谢您的关注！ **Q3、请问澄天伟业高管：介绍一下公司液冷方面的进展，目前订单交付情况以及明年初的订单情况？** 答：尊敬的投资者您好！ 公司液冷散热业务已取得核心客户供应商代码并纳入其合格供应商名录，签署框架性《采购合约》，相关产品实现小批量供货，同时完成初期产线建设，具备承接批量订单的生产条件和交付能力。产能方面，惠州生产基地一期已投产，正积极推进二期扩产准备。公司主要产品为液冷板、冷板模组和分水器（Manifold）等；微通道液冷盖板（MLCP）已完成立项及部分部件研发，正与客户联合开发验证，面向下一代高功率平台。订单与交付方面，公司核心客户已提供产品意向性订单计划及需求预测，公司依据框架合约和客户的滚动计划安排备料与生产，具体业绩指标敬请持续关注定期报告及相关公告，感谢您的关注！

	Q4、贵公司半导体封装材料业务的现状及扩产规划如何？ 答：尊敬的投资者您好！（1）业务现状：公司半导体封装材料主要应用于 MOSFET、IGBT、SiC 等功率半导体器件的封装环节，下游需求集中在新能源汽车、光伏、储能三大领域，直接客户为国内功率半导体封装企业。今年以来该业务收入增速由上半年的同比增长 77.02% 提升至前三季度的同比增长 95.62%，增速进一步提升，主要系下游需求持续旺盛。（2）扩产规划：产能路径上，公司拟以募投项目建设为主要抓手，并结合客户验证进度分批释放产能。该业务部分设备采购周期相对较短，产能建设具备一定弹性。建设节奏上，新产品通常需经过客户验证，验证结果及周期存在不确定性。公司将结合客户需求、产品验证进度、现有产能利用率和募投项目进展审慎安排产能建设，优先保障已通过验证订单的交付，合理控制资本开支。具体经营数据、募投项目投资进度及产能释放情况，请以公司定期报告和正式公告为准。 若下游需求波动、客户验证进度不及预期或行业竞争加剧，可能影响该业务增速及扩产节奏，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注！ **Q5、关于智能卡业务在公司战略中承担什么角色？** 答：尊敬的投资者您好！智能卡是公司发展的根基，产品涵盖 SIM 卡、金融 IC 卡、身份识别卡，并延伸至 eSIM、超级 SIM 卡；海外客户包含 THALES、IDEMIA 等全球头部智能卡企业，国内以运营商客户为主。该业务所属赛道成熟、市场竞争充分，公司暂不安排大规模新增投入，重点维护存量客户、巩固市场份额，按需开展产品与服务升级。智能卡业务持续输出稳定现金流，为公司半导体封装材料、液冷等新业务的培育和拓展提供资金保障。感谢您的关注！ **Q6、本次向特定对象发行股票的进展情况如何？** 答：尊敬的投资者您好！公司于 2026 年 11 月 11 日收到深圳证

	券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序。本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ **Q7、股价波动较大，公司在市值管理与投资者回报上有何安排？** 答：尊敬的投资者您好！二级市场股价受到行业政策、市场偏好等各种因素影响，是多种市场因素综合叠加所反映的结果。长期看，公司坚持聚焦核心业务与创新发展,通过优化资源配置、提升运营效率,实现公司内在价值的持续增长。一方面，公司秉持对全体股东负责的原则，坚持把公司经营业绩提升作为市值管理的根基，聚焦公司主业，积极推动液冷业务发展，公司液冷业务从取得供应商代码、到实现小批量供货，半导体封装材料业务从上半年 77.02%到前三季度 95.62%的增速。公司持续提升发展质量，并积极实施合理的分红回馈股东；2026 年公司实施新一期员工持股计划，并开展回购股份，把核心团队与股东的长期利益绑在一起，彰显管理层对公司未来发展信心。另一方面，公司将继续加强与资本市场投资者的沟通，积极有效地向市场传递公司经营发展成果，让公司内在价值在资本市场市值上体现。感谢您的关注！
风险提示	公司提醒投资者注意：新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，实际收入及盈利水平受客户订单、产品价格、量产节奏等多重因素影响，存在不确定性；随着行业参与者的增加可能将加剧市场竞争；原材料价格波动亦可能对盈利能力产生影响。上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认

	真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026-11-26